LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

### 【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、		<u>殿</u> に納入	<b>、する</b>
2.0mm	ピッチ	電線対基板 コネクタ(1列SM	<u>T品)</u> について規定する。

This product specification covers

the 2.0 mm PITCH WIRE TO BOARD CONNECTOR (SINGLE SMT TYPE) series.

### 【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製 品 名 称	製 品 型 番
Product Name	Part Number
プラグ ターミナル	502438-0*00
Plug Terminal	502438-0*00
プラグ ハウジング	502439-**00
Plug Housing	302439-**00
リセ アセンブリ ストレート	5 0 2 4 4 3 - * * 0 9
Receptacle Assembly ST	302443 **09
リセ アセンブリ エンボス梱包品	
ストレート	502443-**70
Embossed tape packaging of	002110 11,0
Receptacle Assembly ST	
リセ アセンブリ ストレート (カバーテープ付)	502443-**08
Receptacle Assembly ST with Cover Tape	302440 ***00
リセ アセンブリ エンボス梱包品	
ストレート (カバーテープ付)	502443-**60
Embossed tape packaging of	002110 1100
Receptacle Assembly ST with Cover Tape	
リセ アセンブリ ライトアングル	502494-**09
Receptacle Assembly RA	302434 ***03
リセ アセンブリ エンボス梱包品	
ライトアングル	502494-**70
Embossed tape packaging of	302737 ** 70
Receptacle Assembly RA	

\*: 図面参照 Refer to the drawing.

	REV.	Α	В	С	D						
	SHEET	1-20	1-20	1-20	1-20						
		REVIS	E ON P	ONLY		TITLE:					
			3	变更		CLIK-Ma	ate 2.0				
	_ DEVISED		SINGLE	ROW CON	NECTOR						
	D	113635 '17/03/07 A.ISHIKAWA						製品	仕様書		
					THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC				-		
	REV.		DESC	RIPTIO	N	TECHNOLOG	IES, LLC AND SHOU	JLD NOT BE USED WIT	THOUT WRITTEN PERMI	SSION	
	DESIGN CONTROL STATUS		WRITTEN BY: AISHIKAWA	CHECKED BY: KOMURAKAMI	APPROVED BY: TKANEKO	DATE: 2016/04/	27				
DOC	DOCUMENT NUMBER 5024431570			DOC. TYPE	DOC. PART		FOMER ERAL	SHEE <sup>1</sup> 1 OF 2	•		
	EN-127(2015-12)										

LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

### 【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES 】

項目		規	格
Item		Standard	
最大許容電圧 Allowable Voltage (MAX.)	250 V		[ AC (実効値 rms) / DC ]
最大許容電流 及び 適用電線	AWG#22	3.0A	
Allowable Current (MAX.) And Applicable wires	AWG#24	2.0A	被覆外径:φ0.9~φ1.5mm Insulation O.D.
And Applicable wires	AWG#26	1.5A	
使用温度範囲 <sup>*1*2*3</sup> Ambient Temperature Range	低温においてタ	-40℃ ~ +105 ×結しないこと Notfre	5°C eeze in low temperature

\*1:基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。

Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.

\*2:通電による温度上昇分を含む。

This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.

\*3:適合電線も本使用温度範囲を満足すること。

Applicable wires must also meet the specified temperature range.

### 参考許容電流 CURRENT DERATING REFERENCE INFORMATION

AWG	2-circuits	8-circuits	15-citrcuits
	Amps (A)	Amps (A)	Amps (A)
22	4.0	3.0	3.0
24	3.5	2.5	2.0
26	3.0	2.0	1.5

1) 各電流値は参考となります。

Values are for REFERENCE ONLY

2) 閾値は温度上昇30℃以下としています。

Current deratings are based on not exceeding 30° C Temperature Rise.

3) 温度上昇の測定は圧着端子のバレル部にて実施しています。

Temperature Rise is measured in barrel area of crimp terminal.

4) 基板デザインにより温度上昇の結果が異なります。

PCB trace design can greatly affect temperature rise results.

5) 全極に通電し測定しています。

Data is for all circuits powered.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書				
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PER				
	REV.	DESCRIPTION	TECHNOLOG	SIES, LLC AND SHOU	LED NOT BE USED WITHOUT WRITTEN FE	NINISSION	
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
	5024431570			000	GENERAL	2 OF 20	
					EN	127(2015-12	

LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

### 【4. 性能 PERFORMANCE】

4-1. 電気的性能 Electrical performance

	項 目	 条 件	規格
Item		Test Condition	Requirement
4-1-1	接触抵抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧20mV以下、短絡電流 10mA以下にて測定する。(JIS C5402-2-1) Mate connectors and measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX (JIS C5402-2-1)	20 mΩ MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 250Vを印加し測定する。(JIS C5402-3-1/MIL-STD-202 試験法 302)  Mate connectors and apply 250V DC between adjacent terminal or ground. (JIS C5402-3-1/MIL-STD-202 Method 302)	1000 ΜΩ ΜΙΝ.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Strength	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及び ターミナル、アース間に、AC 800V (実効値)を 1分間 印加する。感度電流 2mA (JIS C5402-4-1/MIL-STD-202 試験法 301) Mate connectors and apply 800V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. Trip current 2mA. (JIS C5402-4-1/MIL-STD-202 Method 301)	異常なきこと No Breakdown
4-1-4	圧着部接触抵抗 Contact Resistance on Crimped Portion	ターミナルに適合電線を圧着し、開放電圧20mV以下、 短絡電流10mA以下にて測定する。 Crimp the applicable wire to the terminal, measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA MAX	5 mΩ MAX.

	REVISE ON PC ONLY			TITLE:			
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書				
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	UMENT N	NUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570			PS	000	GENERAL	3 OF 20	
EN-127(2015-12)							

LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

### 4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項目		条件	規格	
Item		Test Condition	Requirement	
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分25±3mmの速さで挿入、抜去を行う Insert and withdraw connectors at the spe rate of 25±3mm/minute.	-	第6項参照 Refer to paragraph 6
		圧着されたターミナルを治具に 固定し、電線を軸方向に 毎分25±3mmの速さで引張る。	AWG#22	39.2N{4.0kgf}MIN.
4-2-2	圧着部引張強度 Crimping Pull out Force	(JIS C5402-16-4)	AWG#24	29.4N{3.0kgf}MIN.
	T dii out i oice	Pull out Force  Fix the crimped terminal to the jig, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 25±3 mm/minute.  (JIS C5402-16-4)		19.6N{2.0kgf}MIN.
4-2-3	圧着端子挿入力 Crimp Terminal Insertion Force	圧着されたターミナルをハウジングに挿え Insert the crimped terminal into the housir	9.8N {1.0kgf} MAX.	
4-2-4	圧着端子保持力 Crimp Terminal Retention Force	ハウジングに装着した圧着されたターミニ毎分 25±3mm の速さで引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 25±3 mm/minute on the terminal assembled in the housing.	9.8N {1.0kg} MIN.	
4-2-5	HDR端子保持力 Header Terminal Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 25±3mm の速さで軸方向に引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate 25±3mm/minute on the terminal assemble in the housing.	e of	2.94N {0.3 kgf} MIN.
4-2-6	ハウジングロック強度 (ポジティブロック) Housing Lock Strength (Positive Lock)	コネクタを嵌合させ、軸方向に毎分25±3速さで引張る。  Mate connectors and apply axial pull out f at the speed rate of 25±3mm/minute.	29.4N {3.0 kgf} MIN.	

REVISE ON PC ONLY			TITLE:					
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書					
	DEV	DECODIDATION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
	REV.	DESCRIPTION						
DOCUMENT NUMBER			DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET		
5024431570			PS	000	GENERAL	4 OF 20		
	EN-127(2015-12)							

LANGUAGE

JAPANESE ENGLISH

### 4-3. 環境性能、その他 Environmental Performance and Others

	項目	条件	規	格
Item		Test Condition	Red	quirement
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 10回 以下 の速さで、挿入、抜去を 30回 繰返す。 Insert and withdraw connectors 30 cycles repeatedly by rate of less than 10 cycles per minute.	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、全ての圧着端子を直列に接続し最大許容電流で熱平衡に達した時の温度上昇を測定する。 (UL498) Mate connectors and all crimp terminals shall be connected in a direct series. The temperature rise shall be measured when the terminal reaches terminal equilibrium allowable current. (UL498)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAX.
		コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態に て、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に 掃 引割合 10~55~10 Hz/分、全振幅 1.52mm の振動を各2時間 加える。(ケーブルは固定 すること)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-3	耐 振 動 性 Vibration	(JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 試験法201) Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test.	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
		(Fix the cable at test.)  Amplitude : 1.52mm P-P  Frequency : 10~55~10 Hz in 1 minute.  Duration : 2 hours in each X.Y.Z.axes.  (JIS C 60068-2-6/MIL-STD-202 Method 201)	瞬 断 Discontinuity	1 micro second MAX.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:			
SEE SHEET 1 OF 20  CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR					仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOCUMENT NUMBER			DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
5024431570			PS	000	GENERAL	5 OF 20
EN-127(2015-12)						

LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Requir	格 rement
		コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態に て、テストパルス半周期、嵌合軸を含む互い に垂直な 6方向 に 490m/s <sup>2</sup> { 50G }、作用時 間11msの衝撃を各3回、合計18回加える。 (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 試験法	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-4	耐 衝 撃 性 Mechanical Shock	Mate connectors and subject to the following shock conditions. 3 shocks shall be applied along 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1 mA current during the test.  (Total of 18 shocks)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
		Test pulse: Half Sine Peak value: 490 m/s² (50 G) Duration: 11 ms (JIS C60068-2-27/MIL-STD-202 Method 213)	瞬 断 Discontinuity	1 micro second MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC				
	REV.	DESCRIPTION	TECHNOLOG	GIES, LLC AND SHOU	LD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERM	IISSION	
DOC	DOCUMENT NUMBER		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570			PS	000	GENERAL	6 OF 20	
	EN-127(2015-12)						

LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 Red	格 quirement
4-3-5	耐 熱 性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、105±2°C の雰囲気中に 96時間放置後取り出し、1~2時間室温に 放置する。 (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 試験法 108) Mate connectors and expose to 105±2°C for	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-0-0		96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  (JIS C60068-2-2/MIL-STD-202 Method 108)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX
4-3-6	耐寒性	コネクタを嵌合させ、-40±3°C の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に 放置する。(JIS C60068-2-1) Mate connectors and expose to -40±3°C for	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-0	Cold Resistance	96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  (JIS C60068-2-1)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
		コネクタを嵌合させ、40±2°C、相対湿度	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-7	耐湿性	90~95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 試験法 103) Mate connectors and expose to 40±2°C,	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-7	Humidity	relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	100 ΜΩ ΜΙΝ.
		be performed. (JIS C60068-2-78/MIL-STD-202 Method 103)	耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3

			REVISE ON PC ONLY	TITLE:						
D SEE SHEET 1 OF 20 CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品						仕様書				
		REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
	DOCUMENT NUMBER 5024431570		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER GENERAL	SHEET 7 OF 20				
				1		EN-1	1 27(2015-12)			

LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
	温度サイクル	コネクタを嵌合させ、 -40±3°C に 30分、 +105±2°Cに 30分。これを1サイクルとし、 5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後1~2時間 室温に放置する。 (JIS C60062-2-14)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
4-3-8	Temperature Cycling	conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed.  5 cycles of:  a) -40±3°C  b) +105±2°C  30 minutes  (JIS C60068-2-14)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.
4-3-9	塩 水 噴 霧			異常なきこと No Damage
4-0-9	Salt Spray	by a gentle wash or dip in running water, after which the specified measurements shall be performed.  NaCl solution  Concentration : 5±1 %  Spray time : 48±4 hours  Ambient temperature : 35±2 °C  (JIS 60068-2-11/MIL-STD-202 Method 101)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE: CLIK-M	TITLE: CLIK-Mate 2.0					
SEE SHEET 1 OF 20 SINGLE ROW CONNECTOR 製品化						·仕様書			
			THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
ļ	REV.	DESCRIPTION	TECHNOLOG	SIES, LLC AND SHOU	LD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERM	MISSION			
DOC	UMENT I	NUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET			
	ļ	5024431570	PS	000	GENERAL	8 OF 20			
			-	•	EN-1	27(2015-12)			

LANGUAGE

	項 目 Item	条 件 Test Condition	規 格 Requirement		
4.0.40	耐亜硫酸ガス	コネクタを嵌合させ、40±2°Cにて 50±5ppmの亜硫酸ガス中に24時間放置す る。	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage	
4-3-10	SO <sub>2</sub> Gas	Mated connectors and expose to the conditions of 50±5ppm SO <sub>2</sub> gas ambient temperature 40±2°C for 24 hours.	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.	
4-3-11		コネクタを嵌合させ、濃度28%のアンモニア水を入れた容器中に40分間放置する。 (1Lに対して25mLの割合)	外 観 Appearance	異常無きこと No Damage	
4-3-11	NH₃ Gas	Mated connectors and expose to the conditions of NH <sub>3</sub> gas evaporating from 28% NH <sub>3</sub> solution for 40 minutes. (Rate is 25ml per 1L)	接触抵抗 Contact Resistance	40 mΩ MAX.	

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR  製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
	DEV	DECODIDATION					
	REV.	DESCRIPTION					
DOC	DOCUMENT NUMBER		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570			PS	000	GENERAL	9 OF 20	
			•		EN-1	27(2015-12)	

LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

	ターミナルまたはピンをフラックスに浸		
ターミナルまたはピンをフラックスに浸し、本体の取付け基準面より0.5mm迄、245±3°Cのはんだに4~5秒浸す。 Dip terminal or pin into flux, and immerse the area up to 0.5mm from the bottom of the housing into solder molten at 245±3°C for 4~5 sec.		濡れ性 Solder Wetting	ピンホールや 隙間なく浸漬面積 の90%以上 90% of immersed area must show no voids, pin holes.
はんだ耐熱性 Resistance to Soldering Heat	赤外線リフロー時 (Reflow by IR Reflow Machine) 第7項の推奨温度プロファイル条件にてリフローを行う。 Using the reflow profile condition below paragraph 7, the product was reflowed. <u>手はんだ時</u> (Reflow by Manual Soldering iron) 端子先端、金具先端より0.2mmの位置まで、350±10°Cのはんだこてにて 最大5秒加熱する。但し、異常な加圧のないこと。 Using a soldering iron (350±10°C for 5 seconds MAX.) heat up the area 0.2mm	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage
	Resistance to	***	ホ外線リフロー時 (Reflow by IR Reflow Machine) 第7項の推奨温度プロファイル条件にてリフローを行う。 Using the reflow profile condition below paragraph 7, the product was reflowed.    手はんだ時 (Reflow by Manual Soldering iron) 端子先端、金具先端より0.2mmの位置まで、350±10°Cのはんだこてにて最大5秒加熱する。但し、異常な加圧のないこと。 Using a soldering iron (350±10°C for 5 seconds MAX.) heat up the area 0.2mm from the tip of the solder tails and fitting nails. However, do not apply excessive pressure to either the terminals or fitting

( ): 参考規格 Reference Standard { }: 参考単位 Reference Unit

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:					
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION					
	DEV	DECORPTION						
	REV.	DESCRIPTION						
DOC	DOCUMENT NUMBER		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET		
	į	5024431570	PS	000	GENERAL	10 OF 20		
			•		EN-1	27(2015-12)		

LANGUAGE

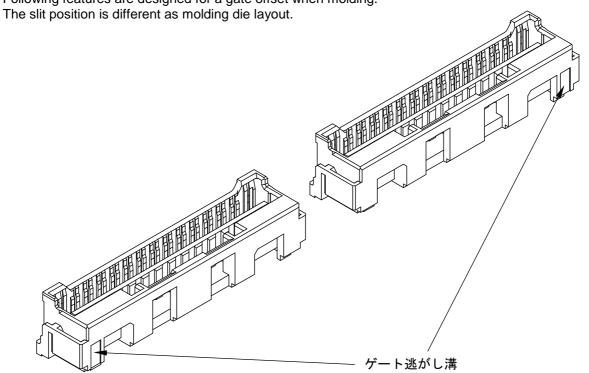
JAPANESE ENGLISH

- 【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】
  - 1. 製品寸法 Dimensions of product

図面参照 Refer to the drawing.

2.リセハウジングの形状について About shape of rec housing

下図に示します溝形状は射出成形時のゲートの逃がしとして設定しております。 溝位置につきましては、金型レイアウトにより異なります。(右側、または左側) Following features are designed for a gate offset when molding.



		REVISE ON PC ONLY	TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
	REV.	DESCRIPTION					
DOC	DOCUMENT NUMBER		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570			PS	000	GENERAL	11 OF 20	
			-	•	EN-1:	27(2015-12)	

LANGUAGE

**JAPANESE ENGLISH** 

### 【6. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

極数	H 10		入力(最大値 sertion (MAX			去力(最小値 ithdrawal (MII	
No. of	UNIT	初回	6回目	30回目	初回	6回目	30回目
CKT		1st	6th	30th	1st	6th	30th
2	N	6.5	7.0	11.0	0.4	0.4	0.4
	{kgf}	{ 0.66 }	{ 0.72 }	{ 1.12 }	{ 0.04 }	{ 0.04 }	{ 0.04 }
3	N	9.7	10.5	15.1	0.6	0.6	0.6
	{kgf}	{ 0.99 }	{ 1.07 }	{ 1.54 }	{ 0.06 }	{ 0.06 }	{ 0.06 }
4	N {kgf}	12.9 { 1.32 }	14 { 1.43 }	18.3 { 1.87 }	0.8 { 0.08 }	0.8 { 0.08 }	0.8 { 0.08 }
5	N	16.2	17.5	21.8	1.0	1.0	1.0
	{kgf}	{ 1.65 }	{ 1.79 }	{ 2.22 }	{ 0.10 }	{ 0.10 }	{ 0.10 }
6	N	19.4	21.5	24.8	1.2	1.2	1.2
	{kgf}	{ 1.98 }	{ 2.20 }	{ 2.53 }	{ 0.12 }	{ 0.12 }	{ 0.12 }
7	N	22.6	24.5	28.6	1.4	1.4	1.4
	{kgf}	{ 2.31 }	{ 2.50 }	{ 2.92 }	{ 0.14 }	{ 0.14 }	{ 0.14 }
8	N	25.9	28	32.3	1.6	1.6	1.6
	{kgf}	{ 2.64 }	{ 2.86 }	{ 3.30 }	{ 0.16 }	{ 0.16 }	{ 0.16 }
9	N	29.1	31.5	35.9	1.8	1.8	1.8
	{kgf}	{ 2.97 }	{ 3.22 }	{ 3.66 }	{ 0.18 }	{ 0.18 }	{ 0.18 }
10	N	32.3	35.4	39.4	2.0	2.0	2.0
	{kgf}	{3.30}	{3.61}	{4.02}	{0.20}	{0.20}	{0.20}
12	N	38.8	42.5	46.3	2.4	2.4	2.4
	{kgf}	{ 3.96 }	{ 4.33 }	{ 4.72 }	{ 0.24 }	{ 0.24 }	{ 0.24 }
13	N	42	46.4	49.6	2.5	2.5	2.5
	{kgf}	{ 4.29 }	{ 4.73 }	{ 5.06 }	{ 0.26 }	{ 0.26 }	{ 0.26 }
14	N	45.3	49.6	52.8	2.7	2.7	2.7
	{kgf}	{ 4.62 }	{ 5.06 }	{ 5.39 }	{ 0.28 }	{ 0.28 }	{ 0.28 }
15	N	48.5	53.1	56.6	2.9	2.9	2.9
	{kgf}	{ 4.95 }	{ 5.42 }	{ 5.78 }	{ 0.30 }	{ 0.30 }	{ 0.30 }

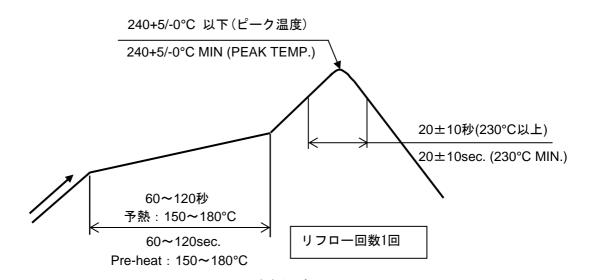
※ロックを解除して測定 Released lock, and measure. { }:参考単位 Reference Unit

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	_	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
	;	5024431570	PS	000	GENERAL	12 OF 20	
				•	EN-1	27(2015-12)	

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

### 【7. リフロー条件 REFLOW CONDITION】



### <u>温度条件グラフ</u> <u>TEMPERATURE CONDITION GRAPH</u>

(はんだ接合部の基板表面にて測定)

(Temperature is measured at the soldering area on the surface of PCB)

注記:本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので 事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。 端子テール部、ネイル部が変色する場合が御座いますが、はんだ付け性には問題ありません。

NOTE: Please check the mount condition (reflow soldering condition) by your own devices beforehand, because the condition changes by the soldering devices, printed circuit boards (PCB), and so on. Although tail of terminal and nail may discolors, a solderability does not have a problem.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE:			
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様			ı仕様 <b>書</b>
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
	į	5024431570	PS	000	GENERAL	13 OF 20
					EN-1	27(2015-12)

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

### 【8. 注記 NOTES.】

- 1. コネクタの嵌合を取り外す際は、かならずロックを解除して行ってください。 When connectors are unmated, positive locks shall be released.
- 2. 本製品のプラスチック部に黒点、気泡等が確認される場合や色合いが異なる場合(経年変化によるハウジングの変色を含む)が御座いますが、製品性能に影響は御座いません。

There is no influence in the product performance though the black spot or bubble etc. might be confirmed to the plastic part of this product and the shade might be different (discoloration by secular distortion etc.).

3. 本製品は錫めっきを使用している為、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、 製品性能に影響は御座いません。

The wound of friction might adhere to externals because the tin plating is used for the tail and nail. But there is no influence in the product performance.

4. 本製品のハウジング及びめっき表面に多少の傷が確認される場合がありますが、 製品性能に問題御座いません。

A few scratches may be confirmed to the surface of the housing and the plating of this product, however, There is no problem in the product performance.

- 5. 本製品のプラスチック部が紫外線により変色する場合がありますが、製品性能には問題御座いません。 Discoloration of the plastic part of this product can result from exposure to ultraviolet light. There is no problem in the product performance.
- 6. 本製品を結露・水濡れが発生する環境でのご使用の場合は、適切な防滴処置をお願い致します。 結露・水濡れにより、回路間で絶縁不良を起こす可能性が御座います。

When this product is used at a place where exposure to water could be expected, please handle with appropriate care to avoid damage from water.

There is a possibility of causing insulated malfunction between the circuits.

- 7. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないでください。 Please do not conduct any washing process on the connectors because it may damage the product's function.
- 8. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部(接点部)が常に動いてしまう状態での御使用は避けてください。 接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。 従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、 共振を抑える等の処置をお願い致します。

Please do not use the connectors in a condition where the wire, PCB, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and PCB, and constant movement of devices.

This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and PCB on the chassis, and reduces sympathetic vibration.

9. コネクタ嵌合状態で基板の持ち運び等コネクタに負荷が掛かる作業は行わないようにしてください。 コネクタ破損等の原因となる場合が御座います。

Please do not do work that the load hangs in the connectors like the carrying of the substrate etc. with the connectors engages. There is a case where it causes the connectors damage etc.

	D	SEE SHEET 1 OF 20		ROW CON	製品	仕様書
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION			
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET
	į	5024431570	PS	000	GENERAL	14 OF 20
			•		EN-1	27(2015-12)

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

10. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットは しないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。

After mated the connectors, please do not allow the PCBs to apply pressure on the connectors in either the pitch direction, the span direction or rotational direction. It may cause damage to the connectors and may crack the soldering.

- 11. 本製品及び加工工程品(仕掛品)や加工品(ハーネス等)の梱包及び輸送・保管時にはコネクタに負荷が加わらないようご注意ください。変形、破損などの原因となり、コネクタの性能不良の原因となります。 Please try to prevent any external forces or shock from being applied to the connectors while the cable assembly is in process, when it is being packaged, or while it is in transportation. This may cause deformation and damage to the connectors and cause a defect in the product's performance.
- 12. 本製品をご使用時には、1PIN当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けてください。 When using this product, please ensure that the specification for rated current per circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.
- 13. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られておりません。 スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないでください。 This product is not designed for the mating and unmating of the connectors to be performed under the condition of an active electrical circuit. It may cause a spark and product defect if the connectors are mated and unmated in this way.
- 14. コネクタに適用できる電線は、原則として錫めっき付き軟銅撚り線です。 その他の電線の使用については別途ご確認ください。

The applicable wire for this connectors, in principle, is tin-plated copper stranded wire. Please consult us and evaluate it in advance when using other wires.

- 15. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にしてください。
  Please keep enough clearance between connectors and chassis of your application in order not to apply pressure on the connectors.
- 16. 電線の結束はコネクタから35mm以上のところで、電線に加わる力が均一になるようにしてください。 ハーネス品で電線一本(又は特定の数本)に力が加わらない様にしてください。 Please tie the cable at least 35mm away from the edge of the connectors and try to ensure that the force is applied evenly on all of the wires.
- 17. 治具等を使用して圧着端子を抜いた場合には、ランスが変形し強度が低下し端子を再装着後の端子保持力が極端に低下します。そのため、圧着端子のリペアの際には新しいハウジングを必ず使用してください。 When extracting a crimp terminal from the housing using a jig, it may deform the housing lance and therefore reduce the terminal retention force enormously after re-inserting of the terminal. Therefore, please ensure to use a new housing after repairing the crimp terminals.

	D	REVISE ON PC ONLY SEE SHEET 1 OF 20	TITLE: CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書			
	REV.	DESCRIPTION		MATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX E JULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERM	LECTRONIC	
DOCUMENT NUMBER 5024431570			DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER GENERAL	SHEET 15 OF 20
			-		EN-1:	27(2015-12)

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

18. ハーネス加工品及びコネクタ嵌合後の電線の引き回しの際、引張りによる力が加わりますと、接点部、結線部(圧着部)やロック部(端子ロック部)が損傷を受け、接触不良の原因となります。 電線の引回し配線をされる場合、コネクタに無理な外力が加わらないように、電線に緩みを持たせ、 余裕を持たせる処置をしてください。

The cable assembly should not have a constant stress or pulling force applied on it when it is in the mated condition. This phenomenon may damage the contact area or wiring area (crimping).

Therefore, when designing the wire positioning, please ensure that there is enough length of wire to avoid stress on the connectors.

- 19. 電線はまとめて軽くつかみ、リセプタクル ハウジングのロックに指を添え、指の平を用いて、ロック解除用バーを押してロックを完全に解除してから、ゆっくり、軸方向にまっすぐに引き抜いてください。また、斜めにこじりながら抜くことは避けてください。コネクタを破損させる恐れが御座います。 Please hold wires all together lightly. After releasing lock completely by attaching fingers to the I ock and pushing bar for releasing lock using flat part of finger, please withdraw receptacle housing slowly, axially and straightly. Please avoid withdrawing them with an angle and roughly. That might cause damage to connector.
- 20. 圧着高さ、状態、適用電線等の詳細は、弊社圧着仕様書: CS-502438-001を参照願います。 The details refer to CS-502438-001 such as crimping satisfied height, state & applicable wire.
- 21. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。
  After mating, please do not take a connector pace direction, a span direction and load to the rotator direction. It causes connector destruction and the solder crack.
- 22. ハウジングのロック部やランス部などの可動部、及び端子を故意に変形させないでください。 製品性能が満足出来ない原因となります。

Do not deform the movable part as lock part and lance part of Plug. HS'G and terminals on purpose. It would lead to product failure.

- 23. はんだ実装部の未はんだは、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタ基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部にはんだ付けを行ってください。 If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connectors to come off of the PCB. Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails on the PCB.
- 24. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認ください。 If there is accidental contact with the connectors while it is going through the reflow machine, there may be deformation or damage caused to the connectors. Please check to prevent this.
- 25. 実装性能(平坦度)は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を 基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとしてください。

The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the PCB. The warpage of the PCB should be a maximum of 0.02mm if measuring from one connectors edge to the other.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品			仕様書	
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
	į	5024431570	PS	000	GENERAL	16 OF 20	
			-	•	EN-1	27(2015-12)	

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

28. 基板実装前後に端子及びネイルに触らないでください。

Please do not touch the terminals and fitting nails before or after mounted the connectors onto the PCB.

29. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。
Please do not stack the PCB directly after mounted the connectors on it.

30. 実装後において手はんだこてによるリペアを行なう際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行なってください。 条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等が原因により 破損の原因になります。

Please conduct it under the condition of the specifications when repairing by hand soldering iron after mounting. In the case of practicing beyond the condition, the backlash, the change in the contact gap, the deformation of the mold and the melting, etc. may cause damage.

31. はんだこてによる手修正を行なう際、過度のはんだやフラックスを使用しないでください。はんだ上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合が御座います。

When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.

- 32. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。
  Please do not use the connectors alone to provide mechanical support for the PCB.
  Please ensure that there is a fixed structure on the phone chassis or other component support for the PCB.
- 33. 本製品の平坦度については、実装前での保証のみであり、実装中および実装後での平坦度については、 保証の限りではありません。

Coplanarity is assured only before mounting.

There is no guarantee of coplanarity after mounting and in the reflow.

34. 弊社の推奨基板パターン寸法を変更して設計を行なう際は、致命的な不良の原因にもなりますのであらかじめご相談ください。

In the case of changing our recommended board pattern size and designing, please consult in advance because it may cause a fatal defect.

35. 本品の一般性能確認はガラスエポキシ基板にて実施していますので、フレキシブル基板等の特殊な基板へ 実装してご使用の際は、別途ご相談願います。

It is necessary to consult separately when mount product on a special PCB or FPC.

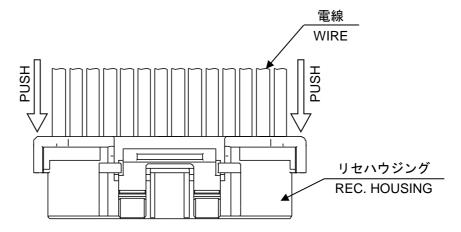
		REVISE ON PC ONLY	TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書				
	REV.	DESCRIPTION			IATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX E ILD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERI		
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570		PS	000	GENERAL	17 OF 20		
			-		EN-1	27(2015-12)	

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

36. 嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。その際、リセハウジングとプラグの外壁同士を合せる様に位置決めした後に押し込み、コネクタ同士が突き当たる(完全嵌合位置)まで真っ直ぐ押し込んでください。 斜めの嵌合になる場合は10°以下の角度でリセハウジングとプラグの外壁同士を軽く当て、位置決めした後に 嵌合してください。尚、コネクタ同士を過度に傾けた状態で嵌合を行いますと、ハウジングが破壊する恐れが 有りますのでこのような嵌合はお避けください。

Please do the mating as much as possible to along to mating axis. At this time, positioning each side of external faces of receptacle housing and plug and push to mating until both connectors strikes each other (complete mating position). In the case of diagonal mating, touch with external faces with receptacle housing and plug under the angle of 10°lightly, and push to mating in order to avoid the connector break.



- 37. リフロー条件によっては端子めっき部にヨリ等が発生する場合がありますが、製品性能には影響ありません。 There is no influence in the product performance though the twist might be generated in the terminal plating part according to the reflow condition.
- 38. リフロー条件によっては樹脂部に変色が発生する場合がありますが、製品性能には影響ありません。 There is no influence in the product performance though discoloration might be generated in the resin according to the reflow condition.
- 39. リフロー後、はんだ付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。 Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not influence the product's performance.
- 40. 本製品は赤外線リフローでの実装を想定しています。N2リフローで実装した場合、リフロー後、はんだ上がりを生じる恐れがあります。N2リフローでの実装をお考えの場合、別途評価が必要になります。Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand. The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, IR reflow machine, Nitrogen reflow machine, and the type of PCB. The different mounting conditions may have an influence on the product's performance.
- 41. 弊社評価では厚さ0.11mm、開口率100%のメタルマスクを使用しています。 Thickness 0.11mm, aperture ratio 100% metal mask is used in this specification.

		REVISE ON PC ONLY	TITLE: CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR				
	D	SEE SHEET 1 OF 20			製品仕様書		
	REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER			DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
		5024431570	PS	000	GENERAL	18 OF 20	
			•	•	EN-1	27(2015-12)	

**LANGUAGE** 

JAPANESE ENGLISH

42. 本製品のハウジング材料は耐熱性ナイロンを使用しており、ハウジングの吸水状態、或いは、はんだ付け条件によっては、リフローはんだ付け時にハウジング表面に「ふくれ」が発生する可能性があります。 この「ふくれ」に関しましては、ナイロン材の物性変化を伴うものではなく、製品機能を損なうものではありません。

The housing material of this product is made from a high heat resistant Nylon. The soldering condition and the water absorption properties of the housing material may cause blistering on the housing surface. Because this blister is not caused by property change, it does not damage the product's features.

43. 本製品のリセプタクルハウジング材料はナイロンを使用しており、吸水状態によって挿抜力・挿入感が変化します。過度な吸水により、挿入時に嵌合相手と若干干渉する場合や、クリック感が弱くなる場合がありますが、製品性能、機能には問題ございません。

Because the receptacle housing material of this product is using Nylons, the water absorption status of the housing material might change insertion force, withdrawal force, or the feeling of insertion. Its excessive water absorption may cause to interfere with insertion a little bit or to weaken the click feeling of the lock when mating. However it does not damage the product's features and functions.

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-M SINGLE	ate 2.0 E ROW CON		仕様書	
					ATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX E		
	REV.	DESCRIPTION	TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	DOCUMENT NUMBER		DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
	5024431570		PS	000	GENERAL	19 OF 20	
	EN-127(2015-12)						

LANGUAGE

REV.	REV. RECORD	DATE	EC NO.	WRITTEN BY :	CHECKED BY:
А	REDRAW&REVISED	2016/04/28	104566	A.ISHIKAWA	KO.MURAKAMI
В	REVISED	2016/08/03	107149	K.YAMADA	K.ASAKAWA
С	REVISED	2016/12/22	111413	K.SATO	A.IDA
D	REVISED	2017/03/10	113635	A.ISHIKAWA	A.IDA

	REVISE ON PC ONLY		TITLE:				
	D	SEE SHEET 1 OF 20	CLIK-Mate 2.0 SINGLE ROW CONNECTOR 製品仕様書				
					ATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX I		
	REV.	DESCRIPTION	TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DOC	UMENT N	IUMBER	DOC. TYPE	DOC. PART	CUSTOMER	SHEET	
5024431570		PS	000	GENERAL	20 OF 20		
			•	<u>'</u>	EN-1	27(2015-12)	